



# Crème à braser DP 5505IC

INTERFLUX®  
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique DP 5505IC

Ver: 3.12 30-09-15

Page 1

## Crème à braser sans plomb, sans halogènes et sans nettoyage

### Description

La crème à braser **DP 5505IC** est sans nettoyage, sans halogènes et sans plomb avec une large fenêtre de process. La **DP 5505IC** est une version optimisée de la DP 5505.

La crème fait preuve d'une grande stabilité dans la production. Elle maintient ses propriétés sous différentes conditions atmosphériques. La crème résiste bien aux températures élevées et à l'humidité.

En plus, la chimie de la **DP 5505IC** a été développé pour réduire la formation des « voids ».

La crème fonctionne aussi très bien avec la refusion en phase vapeur.

La **DP 5505 IC** est absolument sans halogènes, elle garantit une très grande fiabilité après la refusion.

Le pouvoir de nettoyage des résidus après refusion a été optimisée.

Les résidus sont minimums et clairs. Les résidus ne perturbent pas les tests par « flying probe » et les tests « in situ ».

Le produit n'a plus besoin d'étiquetage de sécurité.

La crème à braser **DP 5505IC** est classée **RO LO** suivant les normes IPC et EN.



La photo n'est pas contractuelle



### Plus d'informations:

Profil de refusion	P. 2
Recommandations sur le profil	P. 2
Manipulation	P. 3
Résultats des tests	P. 3
Santé et sécurité	P. 4

### Avantages:

- Grande stabilité. Long temps d'abandon
- Large fenêtre de process
- Très peu de « voids »
- Parfait pour la refusion en phase vapeur
- Nettoyage optimisé
- Peu de résidus après refusion, résidu à surface égale
- Absolument sans halogènes
- Plus d'étiquetage de sécurité.

## Disponibilité

alliages	pourc. metal.	granulométrie	conditionnement
Sn96,5Ag3Cu0,5	sérigraphie: 88%-90%	Standard: classe 3 (25— 45µ)	pot :250g/500g cartouche:
Sn95,5Ag3,8Cu0,7			
Sn95,5Ag4Cu0,5	Dosage: 85%	Les classes 4 et 5 sont disponibles pour certains al- liages	60z: 500g/600g/700g
Sn99Ag0,3Cu0,7			12Oz: 1kg/1,2kg/1,3kg/1,5kg
Sn98,5Ag0,8Cu0,7			seringue: 5CC/10CC/30CC
Sn95,8Ag4,2			autres conditionnements sur demande
Sn99,3Cu0,7			
Autres alliages sur demande			



## Profil de refusion pour les alliages SAC, SnCu et SnAg

### En général

En général, un profil de refusion avec un palier limité est recommandé. Des profils linéaires et avec un palier sont également possibles. Un profil avec palier peut être utilisé afin de limiter les différences de températures du

circuit surtout sur des cartes possédant une grande diversité de composants, ou bien, pour diminuer la présence de "voids".

Quand vous brasez une carte avec de la crème à braser sans plomb, faites attention à ne pas surchauffer les composants, en

particulier quand vous utilisez de la convection ou de l'infrarouge. Il est important de connaître les limites de températures de vos composants. Pour avoir une bonne appréciation de l'état thermique de votre carte, contrôlez votre profil de refusion avec

des thermocouples. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en températures situés sur les côtés, au milieu et à proximité des gros composants.

## Recommandations pour le profil (alliages SnAgCu, SnCu et SnAg)

### Préchauffage

De la température ambiante jusqu'à environ 200°C une pente de 1-3°C/s est conseillée. Des montées en températures plus élevées peuvent détruire des composants en raison de l'humidité absorbée.

### Palier

A partir de 180°C jusqu'à environ 215°C avec une pente de 0-1°C/seconde. Dans certains cas un palier avec une température stable est utilisé pour rendre homogène les températures sur la carte. C'est souvent utilisé

sur des circuits à grande dispersion thermique ou afin de réduire la présence de "voids" dans certains process sans plomb. Pour cela, généralement un palier de 20 à 90 sec. entre 200°C et 215°C est utilisé.

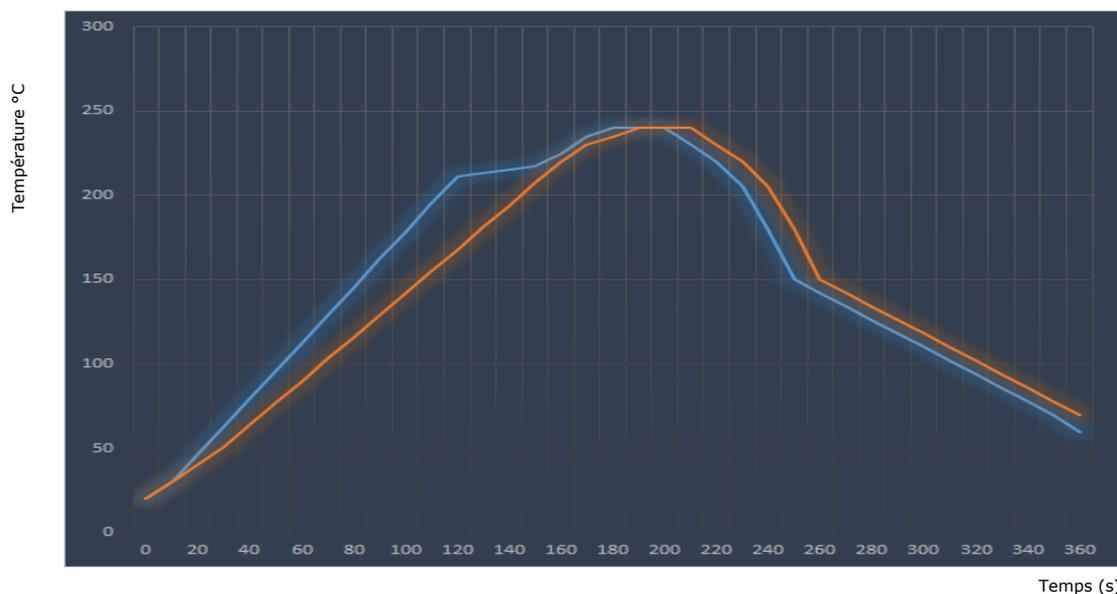
### Refusion

Le pic de refusion dépend des spécifica-

tions des composants. En général entre 235°C et 250°C. Le temps au dessus du liquidus est en général entre 45 et 90s.

### Refroidissement

Pas plus vite que - 4°C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des composants.



Temps (s)



## Manipulation

### Stockage

Stocker la crème à braser dans les pots hermétiques d'origines à environ 3° - 7°C.

### Manipulation

S'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé pour éviter la condensation de l'eau. Mélanger avant toute utilisation.

### Sérigraphie

Assurer une bonne étanchéité entre la carte et le pochoir. N'appliquer pas plus de pression sur les racles que nécessaire, le pochoir après la sérigraphie doit être propre. Appliquer suffisamment de crème à braser sur le pochoir afin que la crème puisse rouler aisément pendant la sérigraphie. Rajouter de la

crème à intervalle régulier.

### Entretien

Un nettoyage régulier sous le pochoir est recommandé afin d'assurer une bonne qualité de sérigraphie. Le produit de nettoyage **ISC8020** est recommandé en lingettes ou en forme liquide.

### Réutiliser la crème

Ne pas mélanger de la crème fraîche avec de la crème déjà utilisée. Ne pas remettre de la crème déjà utilisée dans le réfrigérateur. Remettre l'opercule et fermer le pot avec le couvercle à l'abri de l'humidité. Faites un test de sérigraphie et refusion avant toute utilisation en production.

## Résultats des tests de fiabilité

Propriétés	Résultats	Méthodes
<b>Chimique</b>		
Miroir de cuivre	<b>passé</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes	<b>0,00%</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.28.1
Argent chromate (Cl, Br)	<b>passé</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Classification du flux	<b>RO LO</b>	J-STD-004A
<b>Environnement</b>		
Test SIR	<b>passé</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Propriétés	Résultats	Méthodes
<b>Mécanique</b>		
Test de microbilles	après 15min après 4h	<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43 <b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Test de mouillage		<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
Test d'effondrement	après 15min à 25°C après 10min à 150°C	<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35 <b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35



## Santé et sécurité

La crème à braser DP 5505IC a été optimisée concernant la santé et la sécurité. Le produit n'a pas besoin d'une étiquette de sécurité (GHS) dont la plupart des crèmes à braser sur le marché ont besoin.



*GHS 07 est un symbole de sécurité utilisé pour la plupart des crèmes sur le marché.*

*DP 5505IC n'a pas besoin de cette étiquette*

GHS07

Toujours lire la fiche de sécurité du produit.

Nom commercial du produit : DP 5505IC Low voiding, No-Clean, Halide Free, Lead Free Solder Paste

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

**INTERFLUX®** ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

[www.interflux.com/fr](http://www.interflux.com/fr)

Le document dans une autre langue?:

[www.interflux.com](http://www.interflux.com)